

证券代码：601231
转债代码：113045

证券简称：环旭电子
转债简称：环旭转债

环旭电子股份有限公司

2025 年半年度业绩说明会活动记录

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☒业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他
时间	2025 年 9 月 11 日
地点	同顺路演平台 https://board.10jqka.com.cn/ir
上市公司 参会人员	史金鹏（董事会秘书）、吴新宇（财务长）、黄江东（独立董事）、郭薇（独立董事）
业绩说明会 Q&A 记录	[问题]公司近期公布的中报业绩，净利润同比下滑 18%，今年全年业绩也可能同比下滑，公司业绩将连续三年下滑，公司该如何应对业绩乏力的表现？ [回复]公司自 2022 年以来，经营业绩存在一定下滑，一方面受到了供应链去库存的影响，另一方面也存在因为实施全球化的布局策略，短期内投资效益尚未显现的影响。今年上半年，公司净利润同比下滑 18%，存在一定的一次性因素影响，具体包括了 1）公司在欧洲部分产能的整合所产生的一次性费用，在第二季影响毛利约为 1000 万美金；2）因可转换债券计税利息差异调整缴纳前期企业所得税涉及的滞纳金 1900 万人民币；3）上半年还存在部分信用减值和存货计提的一次性影响。从公司对第三季度的业绩目标来看，公司第三季度的利润率同比基本持平。未来公司将在坚持原有主业深耕的基础上，加快“AI 加速卡”“智能眼镜”等业务的布局，并有望在 2026 年提振业绩。同时着眼未来，与控股股东业务协同并进行垂直整合，布局“光通讯”“PDU 电源模块”等业务领域，以拓展未来的业务增长点。 [问题]消费电子类收入增长 8.6%，主要驱动因素是哪些客户或产品？是否与 AI 穿戴设备相

	关？ 【回复】公司上半年消费电子类收入增长 8.6%主要受益于主要客户市场促销带动销量增加。关于 AI 穿戴设备，公司今年向北美的一家头部眼镜客户提供的是 Wi-Fi 的 SiP 模组；而 N-in-one 的集成度更高的主板模组，公司已经正式拿到了客户的订单，预计明年 N-in-one 模组就会带来比较显著的收入增量。 【问题】公司上半年通讯类营收为何下降？ 【回复】公司 2025 年上半年通讯类产品营收同比下降的主要原因是公司大客户今年在手机通讯类模组上采用了自研芯片，相关模组的工艺制程及测试环节有所变化，使得新产品量产时间相较于上年度略有推迟。 【问题】公司光模块业务进展如何？ 【回复】光通讯业务也是公司正在积极投资布局的业务。公司 7 月底发布了新一代 1.6T 光模块，并自建测试实验室，下一步公司还要加快产品测试、客户送样以及产能投资，尽快实现业务落地。未来两三年，环旭电子计划与控股股东围绕光电共封技术积极开展合作，拓展 CPO 光器件和系统组装的业务。 【问题】PDU 的产品进展如何？ 【回复】在 PDU 的项目上，其前端的制程技术根据目前的市场预估的时间表，大约在 2028 年左右量产落地。但是这个技术的整体开发还需要整个上下游供应链整合，从先进封装一直到板卡系统设计，所以在这方面公司未来会和 ASE 一起合作并大量投资。目前产品的前期支出主要集中在产品的设计开发，生产制造的 capex 目前还没有投资，预计会在 2028 年。 【问题】目前 ai 加速卡的产能有多少？ 【回复】公司 AI 加速卡的产能在 2025 年第三季度产能将达 60K/M，第四季度提升至 90K/M，并进一步投资以达成 135K/M 的月产能目标。除产能扩充外，公司同时也会积极导入智能化制造工艺，提升生产效率与良率，强化高质量产品交付的稳定性与客户的信任，为争取客户服务器主板业务打好基础。
--	---

	[问题]未来2年有望看到消费电子新一轮的创新周期，公司的产品有没有一些新的变化？ [回复]从AI端侧的技术发展趋势看，未来将大幅提升端侧AI模型能力，为消费者提供实时便捷的AI智能服务体验。AI的高算力需要更大内存及更大电池容量的支持，在产品设计上，自然转向小尺寸，低功耗及多功能整合的高集成模块。这个技术迭代趋势，将给SiP业务打开广阔的成长空间。公司今年第三季度开始给北美的一个AI眼镜大客户提供Wi-Fi SiP模组。高集成度的主板模组，公司也已经正式拿到了客户订单，明年上半年可以开始批量出货，为明年的SiP业务带来确定性的大幅增长。在手机的SiP模组应用上，公司也看到大客户在新的应用方向的潜在需求，如果项目落地将会是一个重要的新料号，也将带来显著的业务增量。大客户未来2-3年有望打造丰富的端侧AI产品序列，涵盖手机、可穿戴、智能家居等，各品类产品有望在AI驱动下迎来一轮强劲的换机周期，产业链的供应商都将受益。 [问题]苹果推出摄像头版AI耳机，对公司相关业务的影响如何？ [回复]公司根据客户产品的设计要求提供制造服务，增加新功能可能对SiP模组的集成度或工艺难度造成影响。随着大客户新一轮的创新周期开启，未来端侧AI将带动全系列的产品硬件端升级，AI的高算力需要更大内存及更大电池容量的支持，在产品设计上，自然转向小尺寸，低功耗及多功能整合的高集成模块。这个技术迭代趋势，将给SiP业务打开广阔的成长空间。 [问题]苹果手机的新产品iPhone air的esim模组有贵公司的参与吗？ [回复]公司目前尚未参与到手机端的ESim模组类产品。但随着大客户新一轮的创新周期开启，未来端侧AI将带动全系列的产品硬件端升级，涵盖手机、可穿戴、智能家居等，各品类产品有望在AI驱动下迎来一轮强劲的换机周期，产业链的供应商都将受益。 [问题]汇率波动对上半年业绩影响显著，公司如何管理外汇风险？远期合约策略是否有效？ [回复]公司已采取了相关措施以应对汇率波动风险，具体包括：1）建立制度，完善汇率套保的决策和执行机制。公司以套期保值为交易目的，针对汇率风险制定了《金融衍生品交易业务控制制度》2）树立汇率风险中性理念，将汇率风险管理列入公司高质量发展目标要求。对
--	---

	于日常事项，公司财务部每日对公司外币资产负债净头寸及汇率变动进行统计，每周针对近期市场汇率波动及未来情形进行预测，逐月对套期保值的头寸进行调整。 [问题]公司 AI 加速卡算力多大？用在什么场景？ [回复]公司所代工制造的 AI 加速卡主要的应用场景为 AI 服务器中网络支持。
附件清单（如有）	无
日期	2025 年 9 月 11 日